



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

HTG-500 常规系列

【单组份导热凝胶】规格书



-产品图-

应用特点：

- 高导热性能，低热阻
- 无硅油析出，无污染
- 极佳的操作性

应用领域推荐：

- 半导体块和散热器
- 电源电阻器与底座之间
- 温度调节器与装配表面
- 热电冷却装置
- 高性能中央处理器及显示卡处

理器

包装：

根据不同需求，可以按照
30cc/55cc/300cc等容量，按灌
注包装。

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

储存条件：冷藏或阴暗处储存，

储存温度：< 25℃；

储存湿度：≤70%；

保质期：

在储存条件下：6个月

不符合储存条件下：3个月

产品性能

NO.	参 数	单 位	测试方法
颜 色	深灰色	--	目视
密 度	3.1(±0.5)	g/cc	ASTM D 792
挥 发 份	≤200 (@200°C24H)	PPM	GB269-85
油 离 度	≤0.2 (@200°C24H)	%	SH/T0324-92
瞬间压缩应力	< 10 (@50psi)	%	GB/T 7757-2009
静态压缩应力	< 1 (@50psi)	%	GB/T 7757-2009
挤出速度 @90 psi	≥15	g/min	φ2.41mmEFD注射头
最小填充缝隙	≤0.03	mm	--
粘 接 力	< 15	Psi	--
使用温度	-50~150	°C	--
贮藏温度	25(6 mouths) 4(12 mouths)	°C	--
使用 面 积	@1 mil thickness	13	cm ² /g
	@2mil thickness	6.5	cm ² /g
	@5 mil thickness	2.6	cm ² /g
	@10 mil thickness	1.3	cm ² /g

热学特性

导热系数	5.0(±0.5)	W/m·K	ASTM D 5470
热 阻	≤0.06 (@20Psi)	°Cin ² /W	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥2.5	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	≥10 ¹⁰	Ω·cm	ASTM D 257

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权